

Product Change Notice (PCN)

件名: RZ/G2 製品 組立拠点および BGA 基板ベンダー追加

発行日: 6/16/2025

出荷開始予定日: 5/11/2026

改版履歴:[初版]

変更内容の説明:

RZ/G2M V1.3, RZ/G2M V3.0, RZ/G2H の組立拠点および BGA 基板ベンダーを追加します。

項目		現状	新規(追加)
生産拠点 (Assy)		X	Y
BGA 基板ベンダー		A	G
組立	所在地	日本	台湾
BGA 基板 ベンダー	所在地	日本	韓国

対象製品リスト:

P3 の Part Number リストを参照して下さい。

変更の理由:

製品供給安定化のため。

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響:

外形 : 影響ありません

実装 : 影響ありません

機能 : 影響ありません

品質 : 影響ありません

信頼性 : 影響ありません

製品の識別方法:

製品に印字されているトレースコードから生産履歴のトレースが可能です。弊社営業にお問い合わせください。

信頼性データについて: 提出可能です。弊社営業にお問い合わせください。

サンプル出荷予定日: 11/3/2025 要求ベースの準備になりますので、弊社営業にお問い合わせください。

製品/材料の化学物質データ: 提出可能です。弊社営業にお問い合わせください。

ご注意:

1. PCN をお客様にお渡しした後 30 日以内に受理の御連絡を頂けない場合は、変更内容を御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
2. お客様が PCN を受理されて承認手続きのための条件が有る場合は、PCN をお客様にお渡しした後 90 日以内に御連絡をお願い致します。90 日以内に何の御連絡もない場合も御承認頂いたものとみなして変更を実施させていただきます。
3. 変更内容について御承認頂けない場合、最終注文数の御提示と御発注をお願い致します。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。

付録

対象製品リスト

No.	Device Name	Part Number
1	RZ/G2M V1.3	R8A774A0HA01BG#G2
2		R8A774A0HA01BG#U2
3		R8A774A0HC01BG#G2
4		R8A774A0HC01BG#U2
5		R8A774A1HA01BG#G2
6		R8A774A1HA01BG#U2
7		R8A774A1HB01BG#G2
8		R8A774A1HB01BG#U2
9	RZ/G2M V3.0	R8A774A2HA01BG#GV
10		R8A774A2HA01BG#UV
11		R8A774A3HA01BG#GV
12		R8A774A3HA01BG#UV
13	RZ/G2H	R8A774E0HA01BN#G0
14		R8A774E0HA01BN#G6
15		R8A774E0HA01BN#U0
16		R8A774E0HA01BN#U6
17		R8A774E1HA01BN#G0
18		R8A774E1HA01BN#G6
19		R8A774E1HA01BN#U0
20		R8A774E1HA01BN#U6
21		R8A774E1HB01BN#G0
22		R8A774E1HB01BN#U0